

## La bobina 'dialoga' con la linea di confezionamento

Goglio presenta a Ipack-Ima la tecnologia Fres-co System+ abbinata alla piattaforma IIoT MIND per ottimizzare in modo automatico i processi.

23 maggio 2025 08:46



Soluzioni di packaging che puntano su una maggiore sostenibilità saranno protagoniste nello stand del produttore di imballaggi flessibili Goglio alla prossima edizione di Ipack-Ima, fiera sulle tecnologie per il packaging in programma a Milano la prossima settimana. Un approccio che mette a frutto l'esperienza nei materiali, nella trasformazione e nella progettazione delle macchine per il confezionamento.